

* 본 공고는 석/박사 지원자 대상이오니 학사 지원자는 학사 공고로 지원하여 주시기 바랍니다.

(주)LG화학 2016년 하반기 산학장학생 모집(석/박사)

모집분야

연구부문		연구분야	근무지	모집전공
중앙연구소 (전사 R&D 과제)		<ul style="list-style-type: none"> Platform Tech : 코팅, 분산, 점/접착, 유기/고분자 합성 및 물성, 박막증착, CFD, 고분자유변학, 공정모델링, Optimization, Printing & Patterning, 무기소재 합성/가공, 촉매, 분석 친환경/Energy 소재 : 태양전지소재, 연료전지소재, 차세대 리튬이온전지 고기능신소재 : 차세대 무기/고분자/전도성 소재 바이오 : 바이오소재(케미컬, 고분자), 종자개량/작물보호제/분자농업, 생물정보학 	대전 과천	화학 화학공학 고분자 금속 신소재 재료공학 물리학 생명공학 생물공학 전기/전자공학 기계공학 및 기타 인접분야
기초소재	기초소재 연구소	<ul style="list-style-type: none"> 고부가가치 제품 개발 (메탈로센 촉매, 고흡수성 수지, 합성고무, ABS 등) 친환경·고기능성 소재 개발 (유/무기소재 합성/중합/가공 등) 공정 Modeling, Simulation & Optimization 신소재, 신촉매, 신공정 개발 	대전 여수 과천	
	TECH센터 (TS&D)*	<ul style="list-style-type: none"> 응용기술 : 고분자 가공 공정 설계 및 최적화, 압출/사출성형, 유변학, 전산유체역학, 금형 설계, CAD/CAE활용 기계설계 및 구조해석, Multiphysics, 장기 내구 신뢰성 평가 신시장 개척, 소재 및 가공기술 개발 : PO, PVC/가소제, ABS, EP, 고흡수성 수지, 고무/특수수지 등 	대전	
	EP소재 개발센터*	<ul style="list-style-type: none"> 소재 및 가공기술 개발 : EP 및 Super EP Compound, 기능성/경량화 소재, 나노카본 복합소재 	대전 익산	
정보전자소재	정보전자소재 연구소	<ul style="list-style-type: none"> Display 및 고기능성 필름/반도체 회로 소재 : 필름/고분자 가공, 코팅/진공 증착, 유/무기 Hybrid 소재, 유기/고분자 합성, 표면처리, 점-접착 소재(대전 또는 안양), 고분자 복합재료, 무기재료, 고분자 광설계 수처리 필터 : 멤브레인, 고분자 복합재료, 유/무기 Hybrid 소재, 미세유체공학 Glass 소재 : 무기재료, 금속, 신소재, 화학, 화공 및 기타 인접분야 (파주 근무) 	대전 파주 안양	
재료	재료연구소	<ul style="list-style-type: none"> Display 소재 : 유기화학/고분자 합성 및 물성, 염료 합성, 분산 기술, 코팅 기술 반도체/회로 소재 : 유기합성 / 고분자 중합, 절연재료 자동차/Energy 소재 : 무기화학 / 고분자 중합 및 물성, 전지재료, 접착재료 	대전	
	사업부 제품 개발	<ul style="list-style-type: none"> Display재료 : LCD용 Color/투명/Polyimide 재료 및 분산 기술 개발, OLED물질 합성 공정/증착 기술 개발, Silicone 재료 개발 	대전 청주	
전지	Battery 연구소	<ul style="list-style-type: none"> 소재 및 부품 개발 : 유/무기 소재 합성 및 분석 기술, 금속/고분자 재료 물성 연구, 전기화학 특성 분석 기술, 점착/접착/welding 기술 전기 선행 개발 : 전기화학, 유/무기재료, 열/전기화학 반응 해석, 계면화학, 고분자 물성, 안전성, 신규 전지 구조, 급속충전, Wearable 전지 공정 선행 연구 : 유변학, 표면 흡착, 점착/접착, 금속/고분자 재료 가공, 열/유체/구조 해석, 계면 화학, 전기화학 Pack : 기계설계 분야 (구조+강도/강성+열전달/냉각+차량 진동/충격+대량 생산성 요구 제품 설계), CAE 분야 (차량 진동/충돌 구조 강성/강도 해석, 열전달/냉각계통 해석) BMS : 회로설계, PCB Design 및 SI/PI/EM Simulation, Application S/W개발, S/W Platform개발, Battery Modeling & Safety Algorithm개발 	대전 과천 (Pack/ BMS 일부) 오창 (Pack/ BMS 일부)	
		소형전지 개발센터		
	자동차전지 개발센터	<ul style="list-style-type: none"> Pack System 개발 : 기구 설계 (사출/프레스), 구조/냉각 설계, 구조 해석 및 열 유동 해석/시험, 용접 연구 개발(전기적/기계적 연결) 및 검증 BMS 개발 : H/W 및 S/W 개발, BMS 알고리즘 개발(제어/신호 처리), 전장 설계 (부품/시스템) 및 검증 Cell 개발 : 리튬이온 2차 자동차 전지 설계 및 개발/검증 		
	ESS전지 개발센터	<ul style="list-style-type: none"> Pack System 개발 : 기구설계(사출/프레스), 구조/냉각 설계, 전력망 계통해석 BMS 회로/SW 개발 : HW/SW/FW 개발, 제어/신호처리, SOC 개발 Cell 개발 : 리튬이온 2차전지 설계 및 관련 소재, 소재 합성 및 전기화학 특성 분석 기술 Validation : 배터리 모듈/팩/랙 개발 검증 및 국제인증 (환경/신뢰성/전기적 성능/기계적 특성/안정성 검증 등) 		

1) 기초소재 TS&D(Technical Services & Development)
 - Technical Services : 고객에 대한 기술 지원 및 교육, 고객별 차별화된 Solution활동
 - Development : 차별화된 Premium제품개발 및 용도 개발, 신시장 개척활동

2) EP : Engineering Plastic

※ 전지 R&D 의 Pack, BMS 분야의 경우 기계, 전기/전자공학, 컴퓨터 공학 전공자를 우대함

※ 바이오 관련 연구과제 신설로 생명공학, 생물공학 전공이 추가됨

지원자격

- 2017년 8월 이후 석사, 박사 학위 취득 예정자
(기 졸업자 및 2017년 2월 학위 취득 예정자의 경우 신입 연구원 공고로 지원하여 주시기 바랍니다)
- 해외여행에 결격사유가 없는 자,
- 남성의 경우 입사일 기준 군필, 면제자 또는 전문연구요원 T/O 소지 및 전직 가능자

전형일정



※ 2014년 하반기부터 적성검사 유형에 인문역량(한자, 한국사)이 추가되었으니, 관련 내용은 <http://careers.lg.com>에서 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 전형은 국내에서만 진행이 되오니, 해외에 계신 분들은 참고하여 주시기 바랍니다.

지원방법

- 1) 서류접수 : LG그룹 채용사이트 (<http://careers.lg.com>) 內 LG화학 모집공고에서 On-line 지원
- 2) 제출서류 : 채용사이트 內 입사지원서, 전공요약 발표자료(PDF본)
※ 연구분야 입력 시 공고에 첨부된 전공요약 발표자료를 표지 포함 5장 이내로 작성하여 PDF 파일로 업로드
※ 재학증명서, 성적증명서, 공인어학성적표, 자격증 등은 면접 합격자에 한하여 제출 (추후 안내)
- 3) 접수기간 : 2016.9.1(목) ~ 2016.9.19(월) ☞ 최종 마감일은 오후 2시까지 지원 가능

기타사항

- 1) On-line 접수만 가능합니다. (우편, e-mail 및 방문 접수는 받지 않습니다.)
- 2) 허위기재 사실이 발견될 시에는 즉시 불합격 혹은 입사를 취소합니다.
- 3) 국가보훈대상자 및 장애인은 관련 법규에 의거 우대합니다.
- 4) 각 전형결과 및 통보는 e-mail로 진행되오니, e-mail주소를 정확하게 기재하여 주시기 바랍니다.
- 5) 기타 문의사항 발생 시
 - ① LG Careers Site 內 상단 "채용문의"에서 1:1 질문하기를 통해 문의
 - ② e-mail 및 비밀번호 분실 시 "로그인"에서 이메일주소 및 비밀번호 찾기를 통해 확인
 - ③ LG화학 기술연구원 인사지원팀 (042-870-6825) 으로 문의

※ 공고 마감일은 지원 관련 문의가 많아 답변 및 대응이 늦어질 수 있습니다.
등록 마감 이후, 추가 등록 및 수정이 불가하므로 관련 문의는 반드시 마감 3일 전까지 요청 완료하여 주시기 바랍니다.